

DA 158A3 晶片黏著/TIM 黏合劑產品資料表

卓越的熱循環性能

優異的機械衝擊性能

高導熱性

簡介

DA 158A3 是一種高導熱、電絕緣的快速固化液態環氧樹脂，兼具晶片貼裝膠與熱界面材料的雙重特性。本產品適用於倒裝晶片 (Flip Chip)、晶片級封裝 (CSP)、球柵陣列 (BGA)、堆疊封裝 (PoP) 以及焊盤柵格陣列 (LGA) 等應用領域。此外，它也適用於各類先進封裝結構中的裸晶片保護，例如記憶卡、晶片載體、混合電路及多晶片組件 (MCM) 等。該材料專為高產能生產環境而設計，尤其適用於那些對製程速度和抗機械衝擊性能有著極高要求的應用場景。DA 158A3 具有優異的易點膠特性，可最大限度地降低封裝過程中產生的應力，並提供卓越的可靠性表現 (例如耐溫度循環性能) 及出色的機械強度。

物理特性

产品名称	DA 158A3 晶片連接/TIM 材料
外觀	黑色
未固化材料性能	
屬性	數值
比重 (ASTM D 1475-60)	2.86 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	15 – 20 kcp
固化后材料性能	
硬度 (邵氏) (ASTM D-224)	135 C

C.TE.(ASTM E 831) PPM/°C	$\alpha 1 = 20; \alpha 2 = 78$
填料含量 (%)	85-95
晶片剪切強度 (Kg/mm ²)	2x2mm Silicon die on Pd: 2.1 2X2mm Au silicon die on bare Cu: 2.6 2x2mm Au silicon die on Au: 2.4
導熱率 (W/m·K)	3.5-4.5
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	<5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	<5 ppm
Cl ⁻	<10 ppm
表面絕緣電阻 (J-STD-004)	經過

推薦固化工藝

線上固化, 或在 150°C 下固化 15 分鐘。

註: 15 分鐘的固化時間已包含黏接部位達到所需固化溫度所需的時間。亦可評估採用其他固化曲線。

儲存与保质期

若將材料存放於密封的原包裝容器中, 且溫度保持在 -40 °C, 則保存期限為 6 個月。
若存放期超過此期限, 可能會導致黏度升高。請注意防潮、防止揮發及防止混入異物。
揮發和污染可能會對這些產品的加工性能產生不利影響。



YINCAE Advanced Materials, LLC
93 Broadway
Menands, NY, 12204
T (518) 452-2880
F (518) 452-2779

安全信息

Da 158A3 为一种环保、无毒材料。但在使用和操作过程中，仍建议遵循一般工业卫生规范。有关更详细的安全信息，请参阅本产品的 SDS(安全数据表)。

包装规格

DA 158A3 晶片黏著/TIM 材質提供 10cc 和 30cc 規格。如需订购或获取更多信息，请联系 YINCAE。